



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **银 (Ag)**
导线端子端接区域电镀材料: **银**
壳体內的端子定位力: **不带**
端子大小: **尺寸 4**

产品特性

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
接合插针直径	6.35 mm[.25 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	5 μm[200 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	5.08 – 7.62 μm[200 – 300 μin]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	银 (Ag)
导线端子端接区域电镀材料	银
壳体內的端子定位力	不带
端子大小	尺寸 4
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	125 A

端接特性

产品端接到	母排
-------	----



机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	80
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

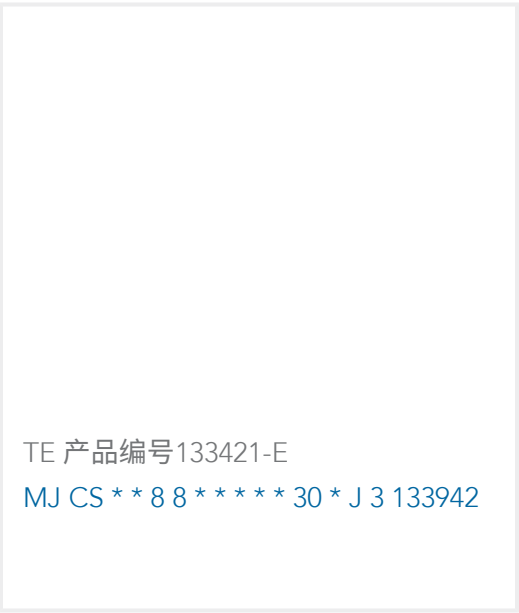


该系列中的其他产品 | ELCON Drawer



客户还购买了





TE 产品编号133421-E
MJ CS ** 8 8 * * * * * 30 * J 3 133942

文档

产品图纸

CONTACT,PIN,#4,M5

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766283-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766283-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1766283-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED

英文版本

AMP & ELCON Power Connector Layout Forms Datasheet 6-1773444-7

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本